中信建投证券股份有限公司

关于

深圳市五株科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市

之

上市保荐书

保荐机构

中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二〇年七月

保荐机构及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭欢、盛芸阳已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目　录

释　义.....3
一、发行人基本情况.....5
二、发行人本次发行情况.....15
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....15
四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....17
五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见.....18
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项.....19
七、本次发行符合相关法律规定.....20
八、持续督导期间的工作安排.....21
九、保荐机构关于本项目的推荐结论.....23

释　义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

一、普通名词释义		
保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
本上市保荐书	指	中信建投证券股份有限公司关于深圳市五株科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书
发行人、公司、五株科技、股份公司	指	深圳市五株科技股份有限公司
控股股东	指	蔡志浩
实际控制人	指	蔡志浩、张小华、蔡诚
五株有限	指	发行人前身深圳市五株电路板有限公司
东莞五株	指	东莞市五株电子科技有限公司，发行人全资子公司
梅州志浩	指	梅州市志浩电子科技有限公司，发行人全资子公司
江西志浩	指	江西志浩电子科技有限公司，发行人全资子公司
梅州五株	指	梅州五株电路板有限公司，发行人全资子公司
江西威力固	指	江西威力固智能设备有限公司，发行人全资子公司
本次发行	指	公司本次向社会公众公开发行不超过7,859万股人民币普通股（A股）的行为
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司章程》	指	《深圳市五株科技股份有限公司章程》
发行人律师、中伦律师	指	北京市中伦律师事务所
发行人会计师、申报会计师、立信会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、最近三年	指	2017 年度、2018 年度、2019 年度
元、万元	指	人民币元、万元
二、专业术语释义		
印制电路板、印刷电路板、PCB	指	Printed Circuit Board，指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板

刚性板、硬板、RPCB	指	Rigid Printed Circuit Board，以刚性基材制成的，具有一定强韧度的印制电路板
单面板	指	在绝缘基材上仅一面具有导电图形的印制电路板
双面板	指	绝缘基材的两面都有导电图形的印制电路板
多层板	指	使用数片单面或双面板，并在每层板间放进一层绝缘基材后压合的印制电路板，具有二层以上导电图形
HDI 板	指	High Density Interconnect，即高密度互连技术。HDI 是印制电路板技术的一种，具备提供更高密度的电路互连、容纳更多的电子元器件等特点
挠性板、柔性板、软板、FPC	指	Flexible Printed Circuit，利用挠性基材制成，并具有一定弯曲性的印制电路板
刚挠板、刚挠结合板、刚柔结合板、软硬结合板、RFPC	指	Rigid-flex Printed Circuit，刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求
高频高速板	指	采用特种的高频覆铜板等基材制造的印制电路板
金属基板、MPCB	指	Metal base Printed Circuit Board，其基材是由电路层（铜箔）、绝缘基层和金属底板三部分构成，其中金属基材作为底板，表面附上绝缘基层，与基层上面的铜箔层共同构成导通线路，铜面上可以安装电子元器组件
4G	指	4th-Generation，即第四代移动通信技术
5G	指	5th-Generation，即第五代移动通信技术
电镀	指	一种电离子沉积过程，利用电极通过电流，使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸
CPCA	指	China Printed Circuit Association，即中国电子电路行业协会，印制电路板行业自律组织，是隶属工信部并经民政部批准成立的具有独立法人资格的国家一级行业协会

本上市保荐书中除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

中文名称：深圳市五株科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Wuzhu Technology Co., Ltd.

注册资本：23,577.00 万元

法定代表人：蔡志浩

有限公司成立日期：2000 年 3 月 29 日

整体变更为股份公司日期：2012 年 1 月 18 日

住所：深圳市宝安区西乡镇钟屋工业区

邮政编码：518000

联系电话：0755-27778289

传真号码：0755-27778389

互联网网址：www.topcb.com.cn

电子信箱：securities@topcb.com.cn

信息披露和投资者关系部门：证券部

信息披露和投资者关系部门负责人：赵尚萍

信息披露和投资者关系部门联系电话：0755-27778289

（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

1、主营业务

公司主营业务为印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于 4G/5G 网络与通信基础设施、智能手机、消费电子、高端服务器、计算机和存储、工控医疗、汽车电子、新能源、航空航天等领域。公司产品具有“一站式、多品种、品质可靠、快速响应”的特点，涵盖精密单/双面板、多层板、高密度互连板（HDI 板）、挠性板（FPC）、刚挠结合板（RFPC）、高频高速板、金属基板（厚铜板、铜基板、铝基板等）等类型。公司现已发展成为国内少数几家能同时大批量生产高多层板、HDI 板、挠性板、高频高速板的印制电路板厂商之一。

公司始终坚持“以创新驱动发展”的战略，重视技术研发，具有较强的自主创新能力。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已取得 356 项专利，其中发明专利 105 项、实用新型专利 249 项、外观设计专利 2 项，取得计算机软件著作权 10 项。公司拥有广东省工程技术研究中心、广东省省级企业技术中心、广东省多功能高阶印制电路板工程技术研究中心、深圳市市级研究开发中心（技术中心）等多个省市级技术研究中心，多个研发项目获得省市级科学技术奖项，在通信应用领域和 HDI 生产制程技术方面具备业内领先的技术优势。

公司凭借二十年的经验积累和技术沉淀，通过持续自主创新，推动产品优化升级，积累了一批优质的客户资源，与华为、中兴、富士康、三星、闪迪、和硕联合、华米等世界 500 强公司以及国际国内知名的通信、智能终端及 EMS 企业建立了长期稳定的合作关系。

五株科技主要客户

华为	中兴	鸿海精密	三星	华勤
和硕	伟创力	闪迪	诺基亚	华米
烽火科技	飞旭	群光	创力仕	闻泰
和辉光电	麦博韦尔	龙旗	共进	百一
欣旺达	传音	世纪云芯	比亚迪	联合技术

公司作为中国电子电路行业协会副理事长单位，参与行业标准的制定，荣获中国印制电路行业优秀民族品牌企业、广东省全国名牌企业、深圳知名品牌、东莞市政府质量奖、东莞市“机器换人”重点示范推广应用项目、江西省智能制造试点示范项目、深圳市手机行业协会最佳手机 HDI 及 FPC 主板供应商等荣誉。根据 N.T. information 发布的 2018 年全球 PCB 制造企业百强排行榜，公司位列全球 PCB 企业中第 45 名，已连续九年入围全球印制电路板制造百强企业排行榜。根据中国电子电路行业协会（CPCA）发布的《中国电子电路行业排行榜——内资 PCB 企业排名》，公司 2017 年-2019 年分别位列第 8 名、第 7 名和第 10 名，位居内资 PCB 企业第一梯队。

2、核心技术

（1）核心技术及技术来源

经过二十年的自主研发和技术积累，公司已形成了多项核心技术，主要情况如下：

序号	核心技术名称	应用阶段	技术来源
1	超高密度任意层互连印制电路板孔金属化工艺及关键技术	批量	自主研发

序号	核心技术名称	应用阶段	技术来源
2	多层超厚盲孔印制电路板制作工艺技术	批量	自主研发
3	不对称盲孔结构的多层盲孔印刷电路板技术	批量	自主研发
4	刚挠结合多层印制电路板涨缩控制及板边定位系统	批量	自主研发
5	高端高阶任意互联 HDI 板技术	批量	自主研发
6	盲孔 HDI 电路板制造工艺技术	批量	自主研发
7	多层混压电路板生产工艺技术	批量	自主研发
8	柔性 HDI 电路板制造工艺技术	批量	自主研发
9	超薄盲埋孔板生产工艺技术	批量	自主研发
10	线路小于 50μm 的电路板工艺技术	批量	自主研发
11	高密度盲埋孔软板技术	批量	自主研发
12	可控钻孔深度高多层背钻工艺技术	批量	自主研发
13	高玻璃化温度厚铜箔印制板技术	批量	自主研发
14	微小孔高厚径比钻孔技术	批量	自主研发
15	4G/5G 终端任意层高密度互连印制电路板关键技术	批量	自主研发
16	印刷电路板制造的高端自动化生产线技术	批量	自主研发
17	金属化半孔电路板生产工艺技术	批量	自主研发
18	高可靠性厚铜箔多层印制板工艺技术	批量	自主研发
19	高多层刚挠结合板关键技术	批量	自主研发
20	柔性电路板 35μm 精细线路技术	批量	自主研发
21	选择性真空树脂塞孔工艺技术	批量	自主研发
22	铜面超粗化工艺技术	批量	自主研发
23	4G/5G 通信高频材料加工技术	批量	自主研发
24	印刷电路板阻抗控制技术	批量	自主研发
25	微波高频印制电路板产品设计及加工技术	批量	自主研发
26	高频混压多层分级金手指关键技术	批量	自主研发
27	盲孔通孔一体填平技术	批量	自主研发
28	高纵横比产品脉冲电镀技术	批量	自主研发
29	细线路动态补偿工艺技术	批量	自主研发
30	薄型产品胀缩控制技术	批量	自主研发
31	中心补偿的叠层对准技术	批量	自主研发
32	任意层互连 PCB 的串扰故障和热效应的测试技术	批量	自主研发
33	芯板电镀填平凹陷控制技术	批量	自主研发
34	电镀表面铜均匀性控制技术	批量	自主研发

序号	核心技术名称	应用阶段	技术来源
35	覆盖膜开窗类刚挠结合板制作工艺技术	批量	自主研发
36	印制电路板阻焊精密开窗技术	批量	自主研发
37	HDI 激光直接烧铜技术	批量	自主研发
38	铝基板生产制造工艺技术	批量	自主研发
39	铜基烧接印制电路板制作技术	小批量	自主研发
40	高频高速信号传输新型 PCB 制作技术	批量	自主研发
41	HDI 板环形电镀填孔技术	批量	自主研发
42	高效自动化电镀工艺技术	批量	自主研发
43	PCB 钻咀影像研磨检测技术	批量	自主研发
44	印刷电路板散热系统	批量	自主研发
45	分段式金手指制作工艺技术	批量	自主研发
46	具有可编程的全自动机械手取放技术	批量	自主研发
47	高多层 PCB 板喷淋系统开发	批量	自主研发
48	高精密蚀刻整机设备开发	批量	自主研发
49	环镀线移载车控制系统关键技术	批量	自主研发
50	直流输出整流设备关键技术	批量	自主研发
51	隧道烤炉全程监控系统技术	批量	自主研发
52	HDI 高难度盲孔镀铜设备制作技术	批量	自主研发
53	具有阶梯结构的钢网技术	批量	自主研发
54	PCB 来料成型尺寸测量技术	批量	自主研发
55	贴片机增加锡膏 Mark 点功能技术	批量	自主研发
56	高端精密光源（LED）线路板产品开发	批量	自主研发
57	5G 线路板材料信号传输损耗研究	批量	自主研发
58	精密细线路动态补偿和二流体蚀刻技术研究	批量	自主研发
59	线路板感光湿膜工艺技术开发	批量	自主研发
60	电路板埋孔树脂填胶后塞技术研究	批量	自主研发
61	局部金属半包边凹槽高频印制板技术研究	批量	自主研发
62	天线基站用高频陶瓷 HDI 板产品开发	批量	自主研发
63	多层背钻高密度孔系统服务器线路板产品开发	批量	自主研发
64	挠性多层密集线路孔模组产品开发	批量	自主研发

3、研发水平

（1）正在研发的项目

截止本上市保荐书签署日，公司正在进行的主要研发项目情况如下：

产品类别	核心技术	所处研发阶段	拟达到的目标
高可靠性 HDI 板	激光 X 形通孔技术开发	样品阶段	高阶 HDI 及任意层互联产品量产，提高产品可靠性问题
	微小 X 形通孔填孔技术开发		
	超薄板电镀技术开发		
	高对准度 HDI 技术		
	高可靠性 HCT 检测技术开发		
	特殊材料压合技术开发		
高精密小间距 LED 板	65um 盲孔 laser 技术开发	样品阶段	高精密 LED 板量产，提高产品封装密度
	65um 盲孔填孔技术开发		
	25um 环的高精度图形技术开发		
	盲孔 100%填平技术开发		
5G 通信基站用多模块集成印制电路板	高中频介质混压信号可靠性传输技术	样品阶段	5G 通信基站用多模块集成印制电路板量产
	低轮廓铜面处理技术		
	高精度线路蚀刻技术		
	高效热释放技术（局部埋嵌铜块和高导热复合材料导热）		
	高密度互连集成技术开发		
挠性多层密集线路孔模组产品	挠性多层压合技术	样品阶段	实现挠性多层密集线路孔模组产品量产
	挠性半孔制作技术		
	25μm 精密细线路制作技术		
5G 通信印制电路板产品	高频高速信号传输技术开发	批量	实现 5G 通信印制电路板产品量产
	40μm/40μm 精细线路制作技术		
	高频高速材料钻孔加工技术开发		
	高频高速材料压合技术开发		
	高频高速材料孔金属化技术开发		
天线基站用高频陶瓷 HDI 板	特殊材料压合技术开发	批量	实现高频陶瓷 HDI 板量产
	陶瓷 HDI 产品金属化技术开发		
	高对准度控制技术开发		
多层刚挠结合板	多层刚挠压合技术	批量	实现多层刚挠结合板量产
	多层刚挠金属化技术		
	多层刚挠成型技术		
	多层刚挠测试技术		

产品类别	核心技术	所处研发阶段	拟达到的目标
高端精密光源线路板	盲孔 100%填平技术	批量	实现高端精密光源线路板量产

（2）最近三年研发费用的构成及占营业收入的比例

报告期内，公司持续加大研发投入，研发支出保持上升趋势。报告期内，公司研发费用占营业收入比例情况如下：

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
研发支出（万元）	13,385.09	10,724.79	9,679.65
研发支出占营业收入比重	5.41%	4.43%	4.60%

公司研发费用主要包括研发人员工资薪酬及福利、物料消耗、折旧等。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动资产	155,883.34	131,324.24	111,229.09
非流动资产	259,383.91	201,590.84	175,384.80
资产合计	415,267.25	332,915.08	286,613.89
流动负债	225,525.14	159,550.05	168,682.38
非流动负债	73,186.57	68,680.14	33,749.62
负债合计	298,711.71	228,230.19	202,432.00
归属于母公司股东所有者权益	116,555.54	104,684.89	84,181.89
所有者权益合计	116,555.54	104,684.89	84,181.89

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
营业收入	247,289.95	242,360.56	210,248.26
营业利润	8,667.54	10,605.07	3,282.50
利润总额	8,633.85	9,605.03	2,545.27
净利润	8,857.98	8,804.80	2,337.18
归属于母公司股东的净利润	8,857.98	8,804.80	2,337.18

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润	9,200.35	9,709.82	3,228.34
基本每股收益（元）	0.38	0.39	0.11
稀释每股收益（元）	0.38	0.39	0.11

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
经营活动产生的现金流量净额	39,772.90	22,641.44	28,825.91
投资活动产生的现金流量净额	-54,613.70	-42,140.20	-26,548.57
筹资活动产生的现金流量净额	20,069.29	24,478.32	2,348.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响	922.14	-13.52	-1,292.83
现金及现金等价物净增加额	6,150.63	4,966.04	3,333.00

4、主要财务指标

主要财务指标	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
流动比率（倍）	0.69	0.82	0.66
速动比率（倍）	0.50	0.62	0.43
资产负债率（母公司）	51.88%	44.11%	46.56%
归属于发行人股东的每股净资产（元/股）	4.94	4.47	3.79
主要财务指标	**2019 年度**	**2018 年度**	**2017 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	34,991.41	35,209.90	28,224.78
利息保障倍数（倍）	1.37	1.89	1.24
应收账款周转率（次/年）	3.53	3.89	3.83
存货周转率（次/年）	4.91	5.18	4.63
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.69	0.97	1.30
每股净现金流量（元）	0.26	0.21	0.15
归属于发行人股东的净利润（万元）	8,857.98	8,804.80	2,337.18
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	9,200.35	9,709.82	3,228.34
研发投入占营业收入的比例	5.41%	4.43%	4.60%

上述财务指标计算公式如下：

1、流动比率＝流动资产/流动负债

2、速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

3、应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额
4、存货周转率＝营业成本/存货平均余额
5、资产负债率（母公司）＝总负债/总资产（母公司）
6、息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息费用＋折旧＋摊销
7、利息保障倍数＝（利润总额＋利息费用）/（利息费用+资本化利息支出）
8、每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
9、每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
10、每股净资产=以期末归属于母公司所有者的权益/期末总股本
11、研发投入占营业收入的比例=研发支出/营业收入

（四）发行人存在的主要风险

1、创新风险

公司所处的印制电路板行业属于技术密集型行业，融合了电子、光学、计算机、材料、化工、机械等多学科知识，工艺复杂、工序较长、技术难度较大。随着集成电路技术和下游应用领域的快速发展，电子产品对印制电路板的密度、集成度、传输速率和稳定性等方面提出了更高要求，PCB 企业需要通过科技创新，以驱动工艺升级、工序优化和技术攻关，从而提高生产效率、促进产品的及时更新换代。由于科技创新本身存在一定的不确定性，若公司未来研发方向偏离行业发展趋势、下游客户需求，或者研发投入未能有效实现成果转换，可能导致公司科技创新无法获得预期效果，对公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响。

2、技术革新的风险

随着信息技术加速向网络化、智能化和服务化的方向发展，以万物互联、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术正广泛渗透到经济社会的各个领域，电子信息产业的技术更新换代不断加快，对印制电路板产品提出了更高要求。若公司未来不能对技术、产品和市场等发展趋势做出正确判断，对行业关键技术的发展方向不能及时掌握，将给公司经营带来不利影响。

3、行业竞争导致盈利能力下降的风险

当前我国印制电路板生产企业数量众多，行业集中度偏低，市场竞争激烈，部分中低端产品面临产能过剩的现状。若公司未来不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步及时进行产品升级和结构调整，以巩固或提高公司市场占有率及竞争力，公司存在因行业竞争加剧造成盈利能力下降的风险。

4、贸易摩擦风险

报告期内，公司出口产品主要销往亚洲、欧洲等国家或地区，出口销售收入占比分别为 25.42%、26.73%和 31.43%。2018 年以来，美国多次宣布对中国商品加征进口关税，印制电路板被列入加征关税名单。尽管公司对美国出口收入金额较低，但若未来中国与美国的贸易摩擦升级或与其他国家产生贸易摩擦，更多的印制电路板终端产品被列入征税清单，可能对公司经营业绩产生不利影响。

5、税收优惠政策变化风险

公司子公司梅州志浩、东莞五株均被认定为高新技术企业，子公司江西志浩、江西威力固均为设立在赣州市且符合国家鼓励类产业发展项目的企业，享受 15%的企业所得税优惠政策。若梅州志浩、东莞五株在高新技术企业证书期满后，不再符合《高新技术企业认定管理办法》的相关要求，不能通过高新技术企业资格复审或重新认定；以及未来西部大开发或赣州市的税收政策进行调整，导致江西志浩、江西威力固无法继续享受上述所得税优惠政策，将对公司未来经营业绩产生一定不利影响。

6、“新冠疫情”引致的经营风险

2020 年以来，新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发，各行各业均遭受了不同程度的影响。因隔离措施、交通管制等防疫管控措施的影响，公司的采购、生产和销售等环节在短期内均受到了一定程度的影响。虽然“新冠疫情”在国内已基本得到控制，公司已经全面复工，但“新冠疫情”对于印制电路板行业的整体影响尚难以准确估计，如果疫情在境外蔓延且持续较长时间，则可能对全球电子行业产业链产生冲击，从而对发行人的经营带来不利影响。

二、发行人本次发行情况

（一）本次发行的基本情况			
股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 7,859.00 万股	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
其中：发行新股数量	不超过 7,859.00 万股	占发行后总股本比例	不低于 25.00%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 31,436.00 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率	【】倍		
发行前每股净资产	【】元	发行前每股收益	【】元
发行后每股净资产	【】元	发行后每股收益	【】元
发行市净率	【】倍		
发行方式	本次发行采取网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，或中国证监会及深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售）		
发行对象	符合国家法律法规和监管部门规定条件的询价对象、在深圳证券交易所开通创业板股票交易权限的符合资格的自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规及发行人必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外），中国证监会、深圳证券交易所另有规定的，按照其规定处理		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	不适用		
发行费用的分摊原则	不适用		
募集资金总额	【】万元		
募集资金净额	【】万元		
募集资金投资项目	江西志浩高精密电路板项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中：承销及保荐费用【】万元，审计验资费用【】万元，律师费用【】万元，信息披露、路演及发行手续费【】万元		
（二）本次发行上市的重要日期			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		

申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日
股票上市日期	【】年【】月【】日

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）本次证券发行的保荐代表人

中信建投证券指定彭欢、盛芸阳担任本次深圳市五株科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

彭欢先生：保荐代表人，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行部总监，曾主持或参与的项目有：天汽模、章源钨业、劲胜智能、木林森、科达利、光莆股份等 IPO 项目；诺普信、南京熊猫、拓日新能、泛海控股、正海磁材非公开发行项目；崇达技术 2017 年可转债、崇达技术 2019 年可转债（在会）；南京熊猫、奋达科技重大资产重组项目。

盛芸阳女士：保荐代表人，管理学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：东方精工、光莆股份、三旺通信（在会）等 IPO 项目；苏交科 2015 年非公开发行、苏交科 2017 年非公开发行、拓日新能非公开发行、光莆股份非公开发行（在会）项目；维格娜丝可转债、香雪制药配股、彩生活私募债项目。

（二）本次证券发行项目协办人

本次证券发行项目的协办人为方英健先生，其保荐业务执行情况如下：

方英健先生：准保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行部经理，曾经参与的主要项目有：明微电子 IPO 项目（在会）、铭普光磁 IPO 项目、中金岭南可转债项目、国科控股非公开发行可交债项目等。

（三）本次证券发行项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员包括陆楠、俞鹏、谭永丰、邱荣辉、徐能来。

陆楠先生：准保荐代表人，经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾主持或参与的项目有：威派格、文灿股份、大参林、中金辐照（在会）、三旺通信（在会）等 IPO 项目；中兴通讯非公开、顺丰控股可转债、崇达技术可转债（在会）等再融资项目。

俞鹏先生：准保荐代表人，财务学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾主持或参与的项目有：三旺通信（在会）、中金辐照（在会）等 IPO 项目；维格娜丝可转债、崇达技术可转债（在会）等再融资项目。

谭永丰先生：保荐代表人，经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁，曾主持或参与的项目有：中航光电、南京熊猫、炼石有色、苏交科非公开项目，崇达技术可转债项目，香雪制药配股项目，中航电子、中航精机、南京熊猫重大资产重组等项目。

邱荣辉先生：保荐代表人，金融学硕士，现任中信建投投资银行部执行总经理，曾主持或参与的项目有：证通电子、翰宇药业、岭南园林、清源股份、光莆股份、博天环境、紫晶存储、三旺通信（在会）、科兴制药（在会）等 IPO 项目，中兴通讯非公开、深圳机场可转债、证通电子非公开、拓日新能非公开、南京熊猫非公开、平潭发展非公开等再融资项目。

徐能来先生：准保荐代表人，经济学硕士，现任中信建投证券投资银行部高级经理，曾主持或参与的项目有：欣贺股份（在会）、科兴制药（在会）等 IPO 项目。

四、关于保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）中信建投证券及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在直接或间接持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在

拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）截至本上市保荐书出具之日，中信建投证券的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或融资的情况；

（五）保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

基于上述事实，保荐机构及其保荐代表人不存在对其公正履行保荐职责可能产生的影响的事项。

五、保荐机构对本次证券发行的内部审核程序和内核意见

（一）保荐机构内部审核程序

本保荐机构在向中国证监会推荐本项目前，通过项目立项审批、投行委质控部审核及内核部门审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。

1、项目的立项审批

本保荐机构按照《中信建投证券股份有限公司投资银行类业务立项规则》的规定，对本项目执行立项的审批程序。

本项目的立项于 2014 年 12 月 15 日得到本保荐机构保荐及并购重组立项委员会审批同意。

2、投行委质控部的审核

本保荐机构在投资银行业务委员会（简称“投行委”）下设立质控部，对投资银行类业务风险实施过程管理和控制，及时发现、制止和纠正项目执行过程中的问题，实现项目风险管控与业务部门的项目尽职调查工作同步完成的目标。

本项目的项目负责人于 2019 年 6 月 2 日、2020 年 4 月 22 日向投行委质控部提出底稿验收申请；2019 年 3 月 25 日至 3 月 29 日、2020 年 4 月 23 日至 4 月 27 日、2020 年 5 月 18 日至 5 月 20 日，投行委质控部对本项目进行了现场核查，并于 2019 年 6 月 5 日、2020 年 6 月 15 日对本项目出具项目质量控制报告。

投行委质控部针对各类投资银行类业务建立有问核制度，明确问核人员、目的、内容和程序等要求。问核情况形成的书面或者电子文件记录，在提交内核申请时与内核申请文件一并提交。

3、内核部门的审核

本保荐机构投资银行类业务的内核部门包括内核委员会与内核部，其中内核委员会为非常设内核机构，内核部为常设内核机构。内核部负责内核委员会的日常运营及事务性管理工作。

本项目于 2019 年 7 月 4 日通过了内核会议审议。内核部在收到本项目的第二次内核申请后，于 2020 年 7 月 2 日发出本项目内核会议通知，内核委员会于 2020 年 7 月 9 日召开内核会议对本项目进行了审议和表决。参加本次内核会议的内核委员共 7 人。内核委员在听取项目负责人和保荐代表人回复相关问题后，以记名投票的方式对本项目进行了表决。根据表决结果，内核会议审议通过本项目并同意向中国证监会、深圳证券交易所推荐。

项目组按照内核意见的要求对本次发行申请文件进行了修改、补充和完善，并经全体内核委员审核无异议后，本保荐机构为本项目出具了发行保荐书。

（二）保荐机构关于本项目的内核意见

保荐机构内核委员会对本次发行进行审议后认为，本次发行申请符合《证券法》及中国证监会相关法规、深圳证券交易所业务规则等规定的发行条件，同意作为保荐机构向中国证监会、深圳证券交易所推荐。

六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

（九）中国证监会规定的其他事项。

七、本次发行符合相关法律规定

（一）保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明

1、董事会的批准

发行人于2020年7月1日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》等关于首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。

2、股东大会的批准

公司于2020年7月16日召开2020年度第三次临时股东大会，审议通过了《关

于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市方案的议案》等关于首次公开发行股票并在创业板上市的相关议案。

经核查，本保荐机构认为，发行人已就首次公开发行股票并在创业板上市履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定的决策程序。

（二）保荐机构关于本次证券上市是否符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》上市条件的说明

1、发行人符合中国证监会规定的创业板发行条件，发行人本次发行前股本总额为 23,577.00 万股，本次拟公开发行股份不超过 7,859.00 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股不低于本次发行后总股本的 25%，故发行人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.1 条第（一）、（二）、（三）款规定的上市条件；

2、依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 2.1.2 条，发行人为境内企业且不存在表决权差异安排的，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项："（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元。"

发行人 2018 年和 2019 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 8,804.80 万元和 8,857.98 万元，因此公司符合最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元的上市标准。

八、持续督导期间的工作安排

发行人股票上市后，保荐机构及保荐代表人将根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等的相关规定，尽责完成持续督导工作。持续督导期为发行上市当年以及其后三年。

事项	安排
（一）持续督导事项	
督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	1、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，确信上市公司向交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 2、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事前审阅（或在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作），对存在问题的

事项	安排
	信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，及时向交易所报告； 3、关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，及时向交易所报告。
督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定； 2、参加董事会和股东大会重大事项的决策过程； 3、建立重大财务活动的通报制度； 4、若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为，及时向中国证监会、交易所报告，并发表声明。
督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人依据《公司章程》进一步完善法人治理结构，制订完善的分权管理和授权经营制度； 2、督导发行人建立对高管人员的监管机制，完善高管人员的薪酬体系； 3、对高管人员的故意违法违规的行为，及时报告中国证监会、证券交易所，并发表声明。
督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人进一步完善关联交易的决策制度，根据实际情况对关联交易决策权力和程序做出相应的规定； 2、督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回避的规定； 3、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告关联交易事项； 4、督导发行人采取减少关联交易的措施。
持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人严格按照招股说明书中承诺的投资计划使用募集资金； 2、要求发行人定期通报募集资金使用情况； 3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的，督导发行人及时进行公告； 4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的，督导发行人严格按照法定程序进行变更，关注发行人变更的比例，并督导发行人及时公告。
持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策程序； 2、督导发行人严格履行信息披露制度，及时公告对外担保事项； 3、对发行人违规提供对外担保的行为，及时向中国证监会、证券交易所报告，并发表声明。
（二）保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息； 2、根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构	1、督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的

事项	安排
配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	相关约定； 2、对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解释或出具依据。
（四）其他安排	在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定。

九、保荐机构关于本项目的推荐结论

本次发行申请符合法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐机构认为：本次首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定；中信建投证券同意作为深圳市五株科技股份有限公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，并承担保荐机构的相应责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市五株科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书》之签字盖章页）

项目协办人签名：

方英健

保荐代表人签名：

彭　欢　　盛芸阳

内核负责人签名：

林　煊

保荐业务负责人签名：

刘乃生

保荐机构法定代表人签名：

王常青

中信建投证券股份有限公司

2020 年 7 月 20 日